

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第3区分

【発行日】平成23年9月1日(2011.9.1)

【公開番号】特開2009-255271(P2009-255271A)

【公開日】平成21年11月5日(2009.11.5)

【年通号数】公開・登録公報2009-044

【出願番号】特願2008-199426(P2008-199426)

【国際特許分類】

B 2 4 B 37/00 (2006.01)

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

B 3 2 B 7/02 (2006.01)

B 3 2 B 27/40 (2006.01)

【F I】

B 2 4 B 37/00 M

B 2 4 B 37/00 P

B 2 4 B 37/00 W

H 0 1 L 21/304 6 2 2 F

B 3 2 B 7/02 1 0 1

B 3 2 B 27/40

【手続補正書】

【提出日】平成23年7月19日(2011.7.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

圧縮弾性率が3 MPa以上10 MPa以下の研磨層と、圧縮弾性率が2 MPa以上10 MPa以下のクッション層との積層体からなり、最大厚みと最小厚みの差が50 μm以下でかつ、積層体の厚みバラツキをクッション層の厚みで除した値が0.15以下であることを特徴とする研磨パッド。

【請求項2】

クッション層が無発泡構造である請求項1記載の研磨パッド。

【請求項3】

クッション層がポリウレタンゴムである請求項1または2記載の研磨パッド。

【請求項4】

研磨層とクッション層が接着剤で積層されている請求項1～3のいずれかに記載の研磨パッド。

【請求項5】

半導体基板の研磨用である請求項1～4のいずれかに記載の研磨パッド。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

上記課題の解決に本発明は以下の構成からなる。

「(1) 壓縮弾性率が3 MPa以上10 MPa以下の研磨層と、圧縮弾性率が2 MPa以上10 MPa以下のクッション層との積層体からなり、最大厚みと最小厚みの差が50 μm以下でかつ、積層体の厚みバラツキをクッション層の厚みで除した値が0.15以下であることを特徴とする研磨パッド。」